

2020-2026年中国集成电路 检测技术行业深度调研与市场供需预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国集成电路检测技术行业深度调研与市场供需预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201910/143854.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

集成电路的测试主要包括芯片设计中的设计验证、晶圆制造中的晶圆检测和封装完成后的成品测试。无论哪个阶段，要测试芯片的各项功能指标必须完成两个步骤，一是将芯片的引脚与测试机的功能模块连接起来，二是要通过测试机对芯片施加输入信号，并检测芯片的输出信号，判断芯片功能和性能指标的有效性。测试机是检测芯片功能和性能的专用设备，测试机对芯片施加输入信号，采集被检测芯片的输出信号与预期值进行比较，判断芯片在不同工作条件下功能和性能的有效性。分选机和探针台是将芯片的引脚与测试机的功能模块连接起来并实现批量自动化测试的专用设备。在设计验证和成品测试环节，测试机需要和分选机配合使用；在晶圆检测环节，测试机需要和探针台配合使用。半导体产业链中检测设备应用环节数据来源：公开资料整理我国集成电路封装测试销售额（亿元）数据来源：公开资料整理我国集成电路市场构成数据来源：公开资料整理

国产封装测试企业已形成一定竞争力。国际先进技术的进入带动我国封测技术的不断提高，当前国内封测产业呈现外商独资、中外合资和内资三足鼎立的局面，长电科技、华天科技、通富微电等内资企业已进入全球封测企业前20名，并通过海外收购或兼并重组等方式不断参与到国际竞争中，如长电科技于2015联合国家大基金、芯电半导体收购了全球第4大封装测试企业星科金朋，整体实力大幅提升；华天科技于2015年完成对美国FlipChipInternational公司100%股权收购，进一步提高了其在国际市场的竞争能力；通富微电于2016完成了对超威半导体苏州公司及AMD槟城各85%股权的收购，先进封装产能得到大幅提升。目前封装测试业已成为我国集成电路产业链中最具有国际竞争力的环节。2016年大陆半导体封装测试的销售额为1564亿元，同比增长113%，占我国集成电路的36%。

中企顾问网发布的《2020-2026年中国集成电路检测技术行业深度调研与市场供需预测报告》依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值！

中企顾问网是国内权威的市场调查、行业分析，主要服务有市场调查报告，行业分析报告，投资发展报告，市场研究报告,市场分析报告,行业研究报告,行业调查报告,投资咨询报告,投资情报，免费报告,行业咨询,数据等，是中国知名的研究报告提供商。

报告目录：第一章 世界集成电路产业运行概况方向第一节 2017年国际集成电路的发展综述一、世界集成电路产业发展历程二、全球集成电路发展状况三、世界集成电路产业发展的特

点四、国际集成电路技术发展状况五、国际集成电路设计发展趋势第二节 美国一、美国集成电路市场格局分析二、美国IC设计面临挑战三、美国集成电路政策法规分析第三节 日本一、日本创大规模集成电路间数据传输最高速纪录二、日本IC制造商整合生产线三、日本IC 标签发展概况第四节 印度一、印度发展IC产业的六大举措二、印度IC设计业发展概况三、印度IC设计产业的机会第五节 中国台湾一、台湾IC产业总体发展状况二、台湾IC产业定位的三个转变三、台湾IC业展望 第二章 中国集成电路产业营运形势分析第一节 2017年中国集成电路产业发展总体概括一、中国集成电路产业发展回顾

数据显示：2016年1-12月中国集成电路进口数量为342,453百万个，同比增长9.1%；2016年1-12月中国集成电路进口金额为227,026,494千美元，同比下降1.2%。2016年1-12月中国集成电路进口量统计表如下表所示：2016年1-12月中国集成电路进口量统计表

月份	数量（百万个）	金额（千美元）	数量同比（%）	金额同比（%）
1月	23,900	15,580,245	1.2	-9.1
2月	20,106	12,965,442	4.3	-6.6
3月	27,082	18,394,678	8	4
4月	28,064	18,331,165	12.1	3.2
5月	28,154	18,208,817	13.8	3.2
6月	28,128	19,027,488	7.4	0.9
7月	28,250	18,233,110	3.2	-3.8
8月	32,448	21,030,855	20.9	6.3
9月	32,635	22,222,603	15	5.9
10月	29,228	19,793,357	14	-2.2
11月	32,125	21,642,061	5.8	-5.1
12月	34,001	24,179,816	8.4	0.3

数据来源：中国海关，中企顾问网整理2017年11月中国集成电路进口量统计表 单位：千美元

商品名称 计量单位 11月 1至11月累计 比去年同期±% 累计比去年同期±%

数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 集成电路 百万个 32,744 27,249,614

341,537 234,448,351 1.7 26.1 10.9 15.7 数据来源：中国海关，中企顾问网整理数据显示

：2016年1-12月中国集成电路出口数量为180,887百万个，同比下降1%；2016年1-12月中国集成电路出口金额为61,021,496千美元，同比下降11.6%。2016年1-12月中国集成电路出口量统计表如下表所示：2016年1-12月中国集成电路出口量统计表

月份	数量（百万个）	金额（千美元）	数量同比（%）	金额同比（%）
1月	13,591	4,856,413	-2.8	6.8
2月	10,423	3,558,579	5.5	6.7
3月	15,315	6,079,787	8.6	33
4月	14,899	5,778,223	-1.2	26.7
5月	14,929	5,346,554	-1.4	-5
6月	16,019	5,583,992	14	-9.3
7月	15,931	5,335,797	7.1	-7
8月	16,075	4,659,097	-5	-24.3
9月	16,406	5,146,326	-0.1	-18.4
10月	14,790	4,807,077	-2.1	-19.5
11月	16,895	5,985,282	-7	-20.6
12月	17,009	6,310,069	-10.6	-26

数据来源：中国海关，中企顾问网整理2017年11月中国集成电路出口量统计表 单位：千美元

商品名称 计量单位 11月 1至11月累计 比去年同期±% 累计比去年同期±% 数量 金

额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 集成电路 百万个 16,450 6,195,801 183,404

59,621,003 -3.3 3 12.1 9.2 数据来源：中国海关，中企顾问网整理二、中国集成电路产业模式转型三、中国IC产业政策扶持加快整合四、中国低碳经济成为集成电路产业新引擎第二节

中国集成电路的产业链的发展分析一、中国集成电路产业链发展概况二、五方面入手促进产业调整振兴三、中国IC产业链的联动是关键第三节 中国集成电路封测业发展概况一、中国IC封装业从低端向中高端走近二、中国需加快高端封装技术的研发三、新型封装测试技术浅析四、IC封装企业的质量管理模式第四节 中国集成电路存在的问题一、中国集成电路产业发展的主要问题二、三大因素制约中国集成电路发展三、中国IC产业的三大矛盾四、中国集成电路面临的机会与挑战第五节 中国集成电路发展战略一、中国集成电路产业发展策略二、中国集成电路产业突围发展策略三、中国集成电路发展对策建议四、中国集成电路封测业发展对策 第三章 中国集成电路检测技术行业市场发展环境分析第一节 国内集成电路检测技术经济环境分析一、GDP历史变动轨迹分析二、固定资产投资历史变动轨迹分析三、中国集成电路检测技术经济发展预测分析第二节 中国集成电路检测技术行业政策环境分析 第四章 中国集成电路发展的关键技术第一节 纳米级光刻及微细加工技术第二节 铜互连技术第三节 亚100纳米可重构SoC创新开发平台与设计工具第四节 SoC设计平台与SIP重用技术第五节 新兴及热门产品开发第六节 高密度集成电路封装的工业化技术第七节 应变硅材料制造技术 第五章 中国集成电路产业的发展关键——检测第一节 集成电路测试服务业分类一、设计验证测试二、晶圆测试三、封装测试1、功能测试2、直流参数测试3、交流参数测试4、可靠性测试第二节 集成电路测试技术处于一个不断发展的新起点一、面临测试质量提升的挑战二、面临设计规模不断发展所带来的测试成本的挑战第三节 芯片的测试速度和引脚数在不断攀升一、测试的速度越来越快二、测试精度越来越高 第六章 2014-2017年中国集成电路产量统计分析第一节 2014-2016年全国集成电路产量分析第二节 2017年全国及主要省份集成电路产量分析第三节 2017年集成电路产量集中度分析 第七章 集成电路测试推动集成电路产业快速发展分析第一节 全球高水平集成电路测试系统的分布第二节 中国集成电路测试技术和系统研发的发展一、发展历程分析二、测试验证系统平台的拥有现状第三节 我国测试行业技术发展存在的问题分析一、能够独立承担专业测试服务的企业严重不足二、高素质的测试技术人员不足三、测试质量有待进一步提高 第八章 中国集成电路测试重点企业分析第一节 北京集诚泰思特测试技术有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业发展战略分析第二节 江门市华凯科技有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业发展战略分析第三节 炬才微电子(深圳)有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业发展战略分析第四节 日月光封装测试(上海)有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业发展战略分析第五节 上海华岭集成电路技术有限责任公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业发展战略分析第六节 上海纪元微科电子有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业发展战略分析第七节 深圳电通纬创微电子股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业发展战略分析第八节 宜硕科技(上海)有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业发展战略分析第九节 英特尔产品(成都)有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业发展战略分析第十节 优特半导体(上海)有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业发展战略分析 第九章 2020-2026年中国集成电路测试行业发展趋势与投资分析第一节

2020-2026年中国集成电路测试行业发展前景分析一、集成电路供需预测分析二、集成电路测试市场预测分析三、集成电路测试竞争预测分析第二节 2020-2026年中国集成电路测试行业

投资分析一、集成电路测试投资机会分析二、集成电路测试投资风险分析1、技术风险2、政策

风险第三节 2020-2026年中国集成电路测试行业盈利预测分析 第十章 2020-2026年中国集成

电路测试发展策略分析第一节 发展低成本测试技术一、企业需求低成本测试二、低成本的芯片测试技术是世界范围内的趋势第二节 研发高端测试技术一、现有的测试设备不能满足市场

需求二、集成电路高端测试技术必须先行第三节 开展对外合作,引进先进测试能力一、政府

支持引进先进测试能力二、打造完整产业链,形成集成电路产业发展的集群效应第四节 政府

扶持,建立社会公共检测平台一、政府在发展集成电路产业方面进一步提高服务功能二、高

瞻远瞩地做好高端集成电路测试技术的储备 图表目录（部分）：

图表：2010-2017年国内生产总值

图表：2010-2017年居民消费价格涨跌幅度

图表：2017年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）

图表：2010-2017年国家外汇储备

图表：2010-2017年财政收入

图表：2010-2017年全社会固定资产投资

图表：2017年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（亿元）

图表：2017年固定资产投资新增主要生产能力

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201910/143854.html>